

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПРИПІКАННЯ МІДІ

P. I. Гарбер, Л. М. Поляков, В. М. Михайлівський

Припікання міді проводилось протягом однієї години у вакуумі 10^{-5} мм рт. ст. при температурах 300 — 900°C і придавлюючих тисках до $20 \text{ кг}/\text{мм}^2$.

Виявлено, що міцність з'єднання визначається площею істинного контакту, яка залежить від твердості блоків при температурі припікання і придавлюючого тиску. При наявності дифузійних процесів площа контакту й міцність зростають. Енергія активації в цьому випадку становить $27,6 \text{ кк}/\text{г}\cdot\text{ат}$ при придавлюючому тиску в $0,7 \text{ кг}/\text{мм}^2$ і спадає до $2,4 \text{ кк}/\text{г}\cdot\text{ат}$ при тиску в $7,5 \text{ кг}/\text{мм}^2$. Останнє можна пояснити впливом поверхневої енергії блоків, яка вивільняється.

Вступ

При вивчені процесів спікання головна увага звичайно приділяється змінам пористості. Зчеплення на контактних поверхнях між порошниками (припікання) мало досліджено. Поряд з тим, що міцність спеченого матеріалу в значній мірі визначається цим зчепленням, питання про сили взаємодії між примикаючими металевими блоками, має велике значення для ряду проблемних задач металофізики. Зокрема, можна припускати, що при деформуванні кристалів виникають тріщини й розриви, які згодом усуваються за допомогою механізму, подібного до процесу припікання блоків.

Загальнозвизнано вважати, що при досить тісному kontaktі між поверхнями металевих блоків, що примикають, утворюється міцне з'єднання. Досліди І. В. Обріємова з слюдою [1] показали, що для відновлення первісної міцності зчеплення між розчепленими по плосчині спайності листочками слюди досить було забезпечити відсутність сторонніх газів, що досягалось шляхом експериментування у вакуумі. Подібні властивості повинні мати і кристали металів [2]. В роботі [3] досліджувалась міцність з'єднання припеченіх блоків технічно чистого заліза. Автори цієї роботи прийшли до висновку, що міцність з'єднання визначається площею істинного контакту, яка залежить від зусилля, що притискує, а також від твердості зразків, що припікаються. Дифузійні процеси, на думку цих авторів, можуть лише сприяти збільшенню фактичної площі контакту за рахунок поверхневої й частково об'ємної рухомості атомів. При цьому вони вважають, що в їх дослідах впливу дифузії не виявлено. Експериментуючи зі сталім за величиною навантаженням, дослідники не змогли виявити співвідношення між величиною тиску та інтенсивністю процесів, що відбуваються при припіканні.

В роботі [4] досліджувалось вільне спікання порошінок міді, які одержані електролітичним методом. При цьому було показано, що порошники припікаються і утворюють компактні конгломерати при порівняно низьких температурах (включаючи кімнатну). Дифузійний характер цих процесів підтверджується тим, що вони відбуваються при відсутності придавлюючих тисків. Однак в роботі [4] не було можливості висвітлити питання про міцність з'єднання при утворенні конгломератів. Тому вва-

жалось цікавим перевірити міцність з'єднань, утворюваних при припіканні мідних блоків, при різних температурах і тиску, що контролюється. Для дослідів була використана мідь марки М-3. Поряд з визначенням міцності з'єднань в цій роботі досліджувались зміни мікроструктури блоків поблизу контактних поверхень, де локалізовані процеси припікання. Для порівняння тисків, що застосовувались, з опором зім'яття використаних зразків була вимірювана температурна залежність твердості цієї марки міді.

Методика та установка

Припікання здійснювалось у вакуумі. Для цього була використана циліндрична вакуумна камера, в якій за допомогою масляного дифузійного насоса підтримувався вакуум, що відповідав тиску 10^{-6} — 10^{-5} мм рт. ст. Всередині камери було змонтовано пристрій, що складався з печі опору, гнізда для укладки зразків, на-вантажуючого пристрою і вантажу (рис. 1). Необхідний тиск здійснювався за допомогою системи важелів і тяг, на які навішувалися вантажі спеціальної форми — 1.

Шарніри, що були виготовлені з шарикопідшипників 2, розміщувалися у таких місцях, де вони не мали б зможи нагріватися під час досліду. Величину прикладеного зусилля можна було встановлювати в межах від 15 до 200 кг відповідним набором вантажів. З метою теплої ізоляції зразків підставка 3 укріплювалась на керамічній трубі 4 за допомогою порожнистого гвинта 6 і плити 5. Теплоізоляція верхньої перекладини 7 здійснювалась таким же способом. Для підігріву зразків використовувалась піч 8, яка складалась з двох частин, з'єднаних по діаметральному перерізу.

Для припікання виготовлялись зразки, які мали форму круглих шайб з різьбою на поверхні, як це показано на рис. 2. Діаметр внутрішнього отвору кожного зразка дорівнював 3 мм. Зовнішній діаметр циліндричного виступу визначався згідно з вибраним тиском припікання й величинсою прикладеного зусилля. В кожному досліді припікання зазнавав стовпчик з п'яти зразків (рис. 3). Змінюючи величину діаметра циліндричних виступів окремих зразків, зібраних в одному стовпчику, можна при одному й тому ж зусиллі проводити дослід одночасно при чотирьох різних тисках на контактних поверхнях в цілком одинакових умовах (температура, тривалість, вакуум). Кільцева форма контактних поверхень забезпечувала підвищену стійкість стовпчика і надійність самого контакту. Спай термопар вводився всередину отвору в стовпчику. Найбільша різниця температури по довжині стовпчика не перевищувала 10° , що перевірялося за допомогою двох термопар. Контактні поверхні зразків оброблялись на токарному верстаті, потім шліфувались наждачними аркушами, після чого ретельно відмивались від абразивів. З метою забезпечення правильної плоскої форми поверхень, що підлягали припіканню, зразки здавлювались між двома загартованими та полірованими плоскими плитами. На-

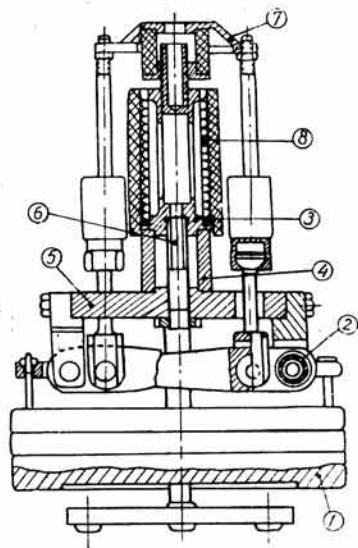


Рис. 1. Установка для припікання у вакуумі: 1 — знімні вантажі; 2 — шарикопідшипникова опора; 3 — гніздо для укладення зразків; 4 — керамічна труба; 5 — установочна плита; 6 — порожнистий гвинт; 7 — на-вантажуюча траверса; 8 — піч опору.

клепка знімалась при наступному відпалі. Підготовка зразків закінчувалась електрополіруванням, обезжирюванням і просушкою у вакуумі зібраного і стиснутого навішаним вантажем стовпця.

Температура доводилась до заданої величини протягом 7—8 хвилин. В процесі підвищення температури тиск в камері не перевищував 10^{-5} мм рт. ст. Задана температура підтримувалась з точністю $\pm 10^\circ$ протягом усього часу припікання, який в усіх дослідах дорівнював одній годині.

Охолодження зразків до 200 — 250° продовжувалось не більше 10 хвилин. Послідуєше охолодження до кімнатної температури тривало значно довше.

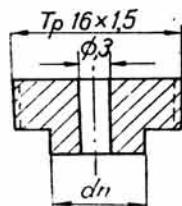


Рис. 2. Схема зразка для припікання.

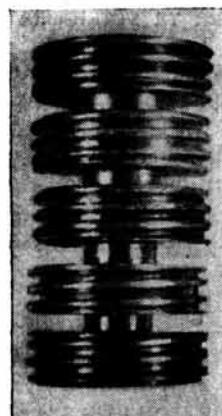


Рис. 3. Стовпчик з п'ятьма зразками, приготовлений для досліду.



Рис. 4. Випадок відриву з частковим зруйнуванням одного з зразків.

Міцність з'єднання після припікання визначалась при кімнатній температурі на дослідній машині ІМ-4Р. На рис. 4 наведена фотографія однієї пари зразків після випробування міцності з'єднання на розрив. Для розриву стовпчик із зразками захватувався в спеціальних затискачах таким чином, щоб зусилля зазнавала лише одна пара зразків; для цього крайній зразок вгинувався в захват, а на припечений до нього зразок надівались розрізні губки другого затискача. Границя міцності з'єднання σ_n визначалась як відношення розривного зусилля до площині кільцевої поверхні. Вимір діаметрів кільця провадився на інструментальному мікроскопі.

Для дослідження мікроструктури блоків поблизу поверхні контакту спечений набір зразків розрізався вздовж діаметральної площини. Поверхня перерізу шліфувалась, полірувалась, травилася на зерно в концентрованій азотній кислоті і старанно промивалась дистильованою водою.

Твердість міді М-3 при $t=300$ — 900° була вимірювана на спеціальній установці у вакуумі (10^{-5} мм рт. ст.) при вдавлюванні в мідний зразок побідітової кульки діаметром 9,02 мм. Кожний зразок спочатку відпалювався у вакуумі при температурі 600° на протязі однієї години. Величина твердості підраховувалась за Мейером, тобто як відношення прикладеного вантажу до площині одержаного відтиску. Звичайно вважають, що таке значення твердості краще, ніж бринелівське, відповідає зім'яттю контакту між двома одинаковими за твердістю матеріалами.

Навантаження при визначені твердості витримувалось протягом однієї години з метою наближення до умов дослідів при припіканні. Діаметр відтиску вимірювався на інструментальному мікроскопі, що дозволило дещо підвищити точність його визначення.

Результати дослідження

На рис. 5 дана залежність найбільшої міцності з'єднання σ_p від тиску припікання при різних температурах. Внаслідок перекосів і інших невправдовідповідностей припікання іноді здійснювалось тільки на частині кільцевої поверхні. На кривих рис. 5 відкладались лише максимальні значення міцності, що були одержані з ряду дослідів при однакових умовах. Як це випливає з рис. 5, в інтервалі температур від 300 до 900° і тисків припікання від 0,2 до 7,5 кг/мм² міцність з'єднання σ_p може бути з задовільною

$$\sigma_p, \text{ кг}/\text{мм}^2$$

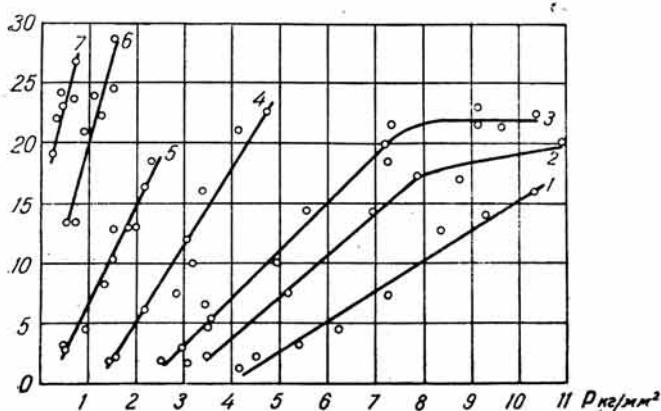


Рис. 5. Залежність граничної міцності з'єднання від тиску припікання: 1 — при 300°; 2 — при 350°; 3 — при 450°; 4 — при 600°; 5 — при 750°; 6 — при 825°; 7 — при 900°.

точністю подана як лінійна функція тиску p . Припікання при температурі нижче 300° і тисках до 27 кг/мм² давало настільки великий розкид величин міцності з'єднання, що утруднювалось однозначне тлумачення результатів. Найменший тиск, необхідний для здійснення припікання в досліджуваному інтервалі температур, тим більший, чим нижча температура. При високих температурах (900°) припікання спостерігалось починаючи з тиску 0,2 кг/мм². Екстраполяція кривих рис. 5 в бік низьких тисків дає при температурі нижче 750° перетин з віссю тисків p , а вище 750° — з віссю міцностей σ_p . Таким чином, при підвищених температурах припікання можливе навіть без притискувального зусилля, тобто при $p=0$.

Очевидно, що значення величини σ_p обмежене міцністю компактної міді σ_b . Однак на рис. 5 помітно, що при занижених температурах (360—450°) має місце тенденція до насичення кривої $\sigma_p=\sigma_p(p)$ з ростом тиску. Найбільше значення σ_p , одержане при температурах 300—450°, виявляється нижче міцності компактної міді.

З метою виявлення температурної залежності міцності з'єднання при припіканні побудовані (за даними рис. 5) криві залежності $\ln \sigma_p$ від обернених значень абсолютної температури (рис. 6).

Параметрами на кривих $\ln \sigma_p = \ln \sigma_b \left(\frac{1}{T} \right)$ обрані деякі значення тисків припікання. Наявність на цих кривих прямолінійних відрізків дає підставу вважати, що процесу припікання при кожному заданому тиску відповідає певна величина енергії активації $Q(p)$, яка пропорціональна тангенсу кута нахилу кривих на рис. 6. Значення $Q(p)$ наведені в табл. 1 і на рис. 7. З рис. 6 видно, що при температурі 300° всі значення міц-

ності занижені. Проте значне підвищення тиску і при цій температурі дає з'єднання високої міцності. Так, наприклад, з дослідів, результати яких не наведені на рис. 5, випливає, що при температурі 300° і тиску $20,4 \text{ кг}/\text{мм}^2$ міцність з'єднання дорівнює $20,2 \text{ кг}/\text{мм}^2$.

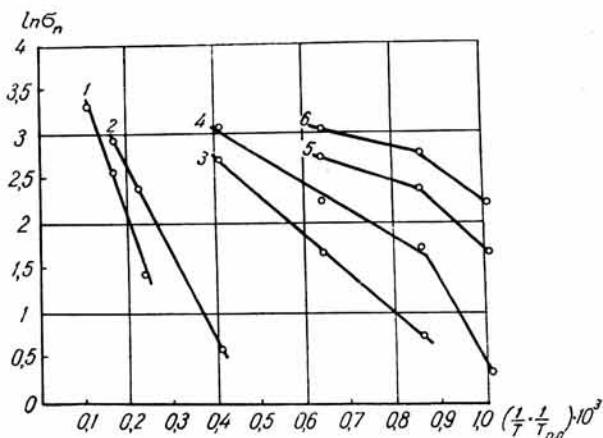


Рис. 6. Залежність логарифма границі міцності від оберненої температури припікання: 1 — при $p = 0,7 \text{ кг}/\text{мм}^2$; 2 — при $p = 1,5 \text{ кг}/\text{мм}^2$; 3 — при $p = 3,5 \text{ кг}/\text{мм}^2$; 4 — при $p = 4,5 \text{ кг}/\text{мм}^2$; 5 — при $p = 6 \text{ кг}/\text{мм}^2$; 6 — при $p = 7,5 \text{ кг}/\text{мм}^2$.

Температурна залежність тиску припікання $p = p(t)$, необхідного для одержання певної міцності з'єднання, що дорівнює $20 \text{ кг}/\text{мм}^2$, наведена на

Таблиця 1

Тиск припікання, p $\text{кг}/\text{мм}^2$	Темпера- тура припікання, t $^\circ\text{C}$	Міцність з'єднання, визначена при кімнатній температурі, σ_n $\text{кг}/\text{мм}^2$	Енергія активації, обчислена за кутовим коефіцієнтом прямолінійних відрізків: кривих рис. 6, (Q/p) $\text{ккал}/\text{с-ам}$
0,7	900	27,0	27,6
	825	13,1	
	750	4,2	
1,5	825	18,6	20,0
	750	10,8	
	600	2,0	
3,5	600	14,8	8,6
	450	5,2	
	350	2,0	
4,5	600	21,2	6,0
	450	9,2	
	350	5,5	
6,0	450	15,1	3,2
	350	10,7	
7,5	450	20,8	2,4
	350	15,9	

рис. 8. Для порівняння там же наведені залежності твердості $H=H(t)$ від температури і відношення $\frac{P}{H}$.

Крива $P=P(t)$ вказує на те, що для одержання рівноміцного з'єднання в області занижених температур ($300-400^\circ$) потрібне різке підвищення тиску. Це можна пояснити відповідним підвищеннем твердості міді в тому ж інтервалі температур, як це випливає з кривої $H=H(t)$ на рис. 8 (див. також табл. 3).

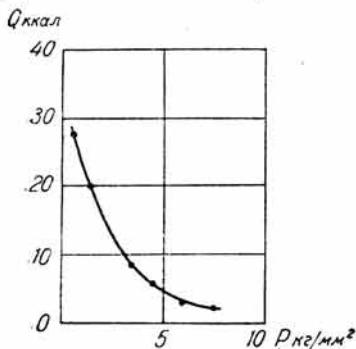


Рис. 7. Залежність енергії активації від питомого тиску припікання.

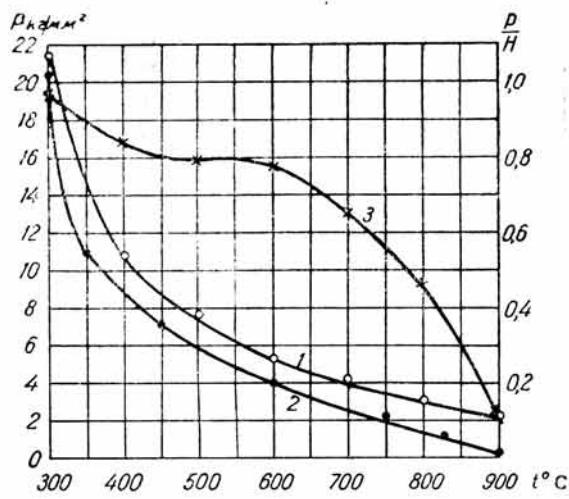


Рис. 8. 1—температурна залежність тиску $P=P(t)$ для рівноміцних з'єднань при $\sigma_n = 20 \text{ кг}/\text{мм}^2$; 2—температурна залежність твердості $H=H(t)$ міді марки М-3 (під навантаженням протягом однієї години); 3—відношення $\frac{P}{H} = \frac{P}{H}(t)$.

Різкий спад кривої $\frac{P}{H}$ при підвищених температурах відображає, очевидно, вплив дифузійних процесів на міцність з'єднання.

На рис. 9—13 наведено мікрографії областей, примикаючих до контактних поверхень тих зразків, які припікались в умовах, що приводять до утворення міцністю від $21,5$ до $23,6 \text{ кг}/\text{мм}^2$.

Зміни температури компенсувались відповідними змінами тиску. Легко помітити, що з підвищением температури розміри окремих кристалітів різко збільшуються, (хоч міцність одержаних з'єднань практично однакова). Звертає на себе увагу те, що всі кристали, які утворилися поблизу границі переділу, зберігають слід цієї границі у вигляді ланцюжка пустот, пузирів і включень.

Очевидно, кристалізація по обидва боки границі переділу відбувалась так, що лише окремі містки служили орієнтуючими затравками. Для такої рекристалізації нема необхідності у переносі речовини з одного блока в інший. Нові кристаліти будуються з «місцевого» матеріалу, тобто практично бездифузійно або при дуже обмеженій участі дифузійних процесів. Аналогічний дослід мікроструктури зразків, що використовувались при визначенні твердості, показав, що тиск в межах застосованих напруг не впливає на величину зерна при рекристалізації, яка повністю визначається тривалістю і температурою досліду.

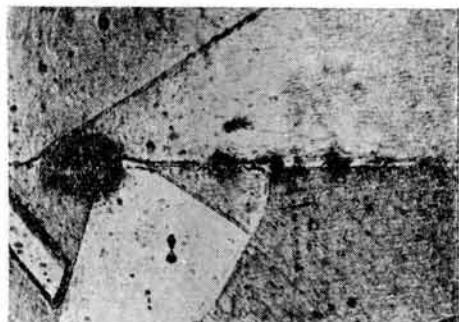


Рис. 9. $\sigma_{\text{н}} = 23,6 \text{ кг}/\text{мм}^2$; $t = 900^\circ$;
 $p = 0,52 \text{ кг}/\text{мм}^2$.

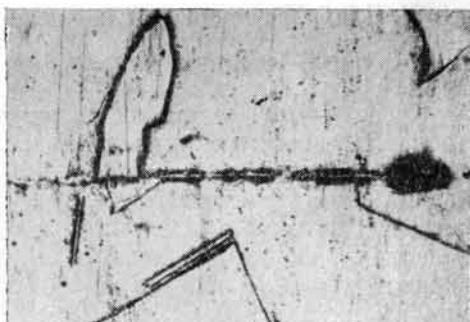


Рис. 10. $\sigma_{\text{н}} = 20,5 \text{ кг}/\text{мм}^2$; $t = 900^\circ$;
 $p = 0,27 \text{ кг}/\text{мм}^2$.

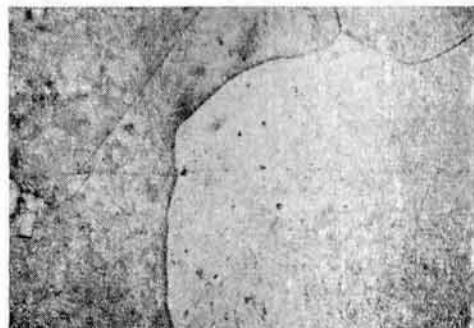


Рис. 11. $\sigma_{\text{н}} = 21,5 \text{ кг}/\text{мм}^2$; $t = 825^\circ$;
 $p = 1,11 \text{ кг}/\text{мм}^2$.

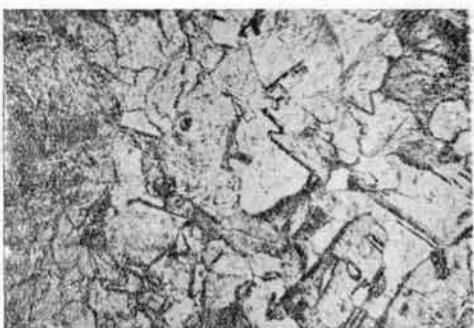


Рис. 12. $\sigma_{\text{н}} = 22,5 \text{ кг}/\text{мм}^2$; $t = 600^\circ$;
 $p = 4,75 \text{ кг}/\text{мм}^2$.

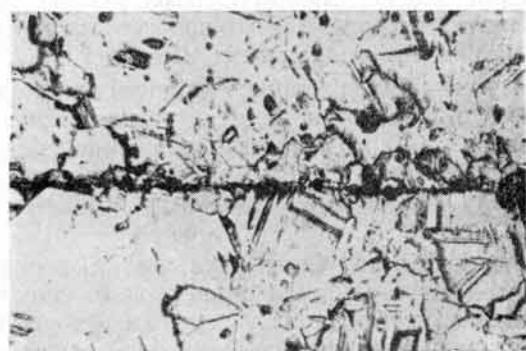


Рис. 13. $\sigma_{\text{н}} = 22,5 \text{ кг}/\text{мм}^2$; $t = 450^\circ$;
 $p = 8,73 \text{ кг}/\text{мм}^2$.

Мікрофотографії шліфів області контакту між припеченіми блоками ($\times 70$). Тут $\sigma_{\text{н}}$ — міцність з'єднання, встановлена при кімнатній температурі при випробуванні на відрив; t — температура припікання; p — придавлюючий тиск при припіканні. Тривалість витримки при вказаних температурах в усіх випадках — одна година.

Таблиця 2

Температура $t, ^\circ\text{C}$	300	350	450	600	900
Довжина дифузійного переміщення атомів міді, що визначена за формулою $V\sqrt{D\tau}, \text{ см}$	$0,25 \cdot 10^{-8}$	$1,85 \cdot 10^{-8}$	$45 \cdot 10^{-8}$	$0,14 \cdot 10^{-4}$	$9,32 \cdot 10^{-4}$

Обговорення результатів

Вищеописані досліди свідчать, що припікання — складний комплекс процесів. Результат припікання, який оцінюється за міцністю одержаного з'єднання, визначається головним чином температурою, придавлюючим тиском, пластичними якостями металічних блоків, якістю поверхень, природою і розподілом забруднень на контактуючих поверхнях. В наших дослідах вплив цих факторів, крім перших трьох, був по можливості стабілізований, причому пластичні якості металів розглядалися як певна функція температури.

Тому, по суті, досліджено лише вплив температури і придавлюючого тиску.

Згідно з [3] можна вважати, що міцність з'єднання цілком залежить від величини істинної сумарної площини контакту, яка визначається лише придавлюючим тиском і твердістю блоків, що спікаються. В цій роботі показано, однак, що в процесі припікання міцність зростає за рахунок дифузійного переміщення матеріалу.

Тому доводиться серйозну увагу приділяти тепловому руху і роботі переміщення атомів. Можливо, що роль дифузійних процесів зводиться тільки до збільшення площини контакту між блоками. Експериментуючи з однокомпонентними матеріалами, ми можемо уникнути створення сплавів і питання міцності з'єднання розв'язувати тільки як проблему наближення атомів до нормальних для даного металу міжатомних відстаней в кристалічній гратці. Звертаючись до дифузійних процесів, що забезпечують таке наближення, ми повинні виходити з даних самодифузії. Довжини самодифузійного переміщення атомів міді на протязі однієї години для різних температур наведені в табл. 2.

У вищеописаних дослідах було досягнуто досить міцне з'єднання блоків міді, що спікалися при температурі 300° , тобто в умовах, коли, згідно з даними табл. 2, відстань дифузійного переміщення атомів на порядок величини менша, ніж стала кристалічної гратки. Це дозволяє твердити, що об'ємна дифузія не є необхідною для пояснення процесів припікання.

Дифузійні процеси, очевидно, відіграють помітну роль при більш високих температурах, особливо коли врахувати, що коефіцієнт поверхневої дифузії може бути значним.

В тих випадках, коли дифузійні процеси на границі відіграють істотну роль для описаних тут дослідів (це має місце починаючи з 350°), а переміщення атомів (обчислене за формулою $x = V\sqrt{D\tau}$) стає більшим за міжатомні відстані, міцність з'єднання повинна бути пропорціональна експоненті $\frac{Q(p)}{kT}$.

Цей висновок підтверджується прямолінійністю кривих $\ln \sigma_n = \ln \sigma_{n_0} \left(\frac{1}{T} \right)$

Таблиця 3

Температура, t °C	300	400	500	600	700	800	900
Тиск p , $\frac{\kappa^2}{\text{мм}^2}$ *	20,4	9,0	9,0	5,9	4,0	2,7	0,27
Твердість H , $\frac{\kappa^2}{\text{мм}^2}$	21,4	10,7	7,6	5,20	4,1	2,95	2,14
$\frac{p}{H}$	0,97	0,84	0,78	0,79	0,66	0,47	0,13

* Тут наведені тиски, що забезпечують в процесі припікання при вказаних температурах міцність з'єднання $\sigma_{\text{н}} = 20 \text{ кг}/\text{мм}^2$.

(рис. 6) в інтервалі температур від 350 до 900°. Злам кривих при 350° можна пояснити тим, що саме при цій температурі \sqrt{Dt} приблизно дорівнює міжатомній відстані. Вважаючи $Q(p)$ за енергію активації, ми повинні пояснити причину різкого її зменшення в міру збільшення придавлюючого тиску p , а також те, що при p , близькому до нуля, $Q(p) = \frac{1}{2}Q$, де Q — енергія активації при самодифузії міді.

Відмінність $Q(p)$ від Q легко віднести за рахунок того, що в наших дослідах істотну роль відіграють явища поверхневої дифузії, для якої енергія активації завжди нижча, ніж для об'ємної. Але закономірне її зниження (при підвищенні придавлюючого тиску) до 2,4 ккал/г-ат потребує фізичної інтерпретації. Можна припустити, що при підвищенні тиску збільшується доля поверхневої енергії, що вивільняється, а це приводить до зменшення величини $Q(p)$, яка, взагалі кажучи, складається з різниці $Q(0) - f(p, \alpha)$, де α — коефіцієнт поверхневого натягу металу при температурі припікання.

Висновки

1. Дослідження міцності з'єднань блоків міді, одержаних припіканням, дають підставу твердити, що міцність з'єднання визначається площею істинного контакту, який утворюється в процесі припікання. Вона не залежить від взаємного проникнення атомів блоків, що спікаються, і рекристалізаційного росту зерен.

2. Величина площи контакту визначається твердістю блоків, що припікаються, при температурі досліду, і придавлюючим тиском; в процесі припікання можливе також і дифузійне збільшення цієї площи, якщо припікання провадиться при досить високих температурах і триває відносно довго.

3. При наявності дифузійних процесів є можливість визначити енергію активації, яка становить приблизно половину енергії активації самодифузії при дуже малих придавлюючих тисках і зменшується до 2,4 ккал/г-ат при тиску 7,5 кг/мм². Така залежність енергії активації від тиску може бути пояснена, якщо вважати, що із збільшенням тиску вивільняється еквівалентна частина поверхневої енергії блоків, що припікаються.

ЛІТЕРАТУРА

1. И. В. Обреимов, Proc. Roy. Soc., A, 127, 291 (1930).
2. Е. М. Лифшиц, ДАН ССР, 97, 4, 643 (1954).
3. Н. Held, Н. Hendus, Zs. Metallkunde, 45, 3 (1954).
4. Р. И. Гарбер и С. С. Дьяченко, ЖТФ, 22, 7, 1097 (1952).

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИПЕКАНИЯ МЕДИ

Р. И. Гарбер, Л. М. Поляков, В. М. Михайловский

Р е з ю м е

Настоящее исследование было предпринято в связи с проблемой прочности спеченных металлов, конгломератов порошков и пластичности деформированных металлов.

В последнем случае можно полагать, что процесс пластической деформации сопровождается образованием большого количества микротрещин и разрывов, которые «залечиваются» в результате припекания, особенно при наличии прижимающих давлений. Такое предположение может быть хорошо использовано при объяснении влияния характера напряженного состояния и температуры на пластичность металлов. Работы [1, 2] дают основание считать, что прочность соединения зависит исключительно от величины площади истинного контакта; в работе [3] высказывается утверждение, что в процессе припекания диффузионные явления не играют существенной роли. В [4] было показано, что конгломераты порошков меди образуются при невысоких температурах, начиная с комнатной. Для сопоставления этих данных было решено исследовать прочность соединения медных колец при различных прижимающих давлениях и температурах, с целью получить количественные данные в возможно более широком интервале температур и давлений. Опыты проводились в вакууме при давлении 10^{-5} мм рт. ст. Установка позволяла одновременно спекать пять колец, сложенных столбиком (рис. 1, 2 и 3). Прочность соединения определялась при комнатной температуре. В табл. 1 и на рис. 5, 6, 7 и 8 приведены результаты измерений. Прочность соединения, как это видно из рис. 5, возрастает с увеличением прижимающего давления. При более высоких температурах эта зависимость приблизительно линейна. При пониженных температурах обнаруживается насыщение. На рис. 6 приведена зависимость логарифма прочности соединения от обратной температуры. Прямолинейность этих кривых позволяет приписать процессу припекания определенную энергию активации, которая уменьшается с ростом прижимающих давлений, как это показано на рис. 7. Отмечается снижение всех данных для температуры ниже 350° , которое можно объяснить тем, что при этих температурах и установленной продолжительности опыта (1 час) диффузионные перемещения атомов меди заведомо ниже параметра решетки (см. табл. 2).

На рис. 8 нанесены давления, необходимые для того, чтобы при различных температурах получать равнопрочные соединения (1), твердость меди при тех же температурах (2), а также отношение этих величин (3).

Перечисленные графики, как и другие данные, дают основание заключить, что прочность соединения определяется площадью истинного контакта. Она не зависит от взаимного диффузионного проникновения атомов и рекристаллизации. Величина площади контакта определяется твердостью блоков при температуре опыта и значением прижимающего давления. При повышенных температурах и продолжительных выдержках возможно также и диффузионное увеличение площади контакта. В последнем случае можно оценить энергию активации, которая снижается очень сильно с повышением прижимающего давления. Такую зависимость можно объяснить освобождением части поверхностной энергии под действием прижимающего давления.